

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第5530856号
(P5530856)

(45) 発行日 平成26年6月25日 (2014. 6. 25)

(24) 登録日 平成26年4月25日 (2014. 4. 25)

(51) Int. Cl.		F I	
H O 1 L 21/26	(2006. 01)	H O 1 L 21/26	F
C 3 O B 29/06	(2006. 01)	H O 1 L 21/26	T
C 3 O B 33/02	(2006. 01)	C 3 O B 29/06	B
		C 3 O B 33/02	

請求項の数 11 (全 14 頁)

(21) 出願番号	特願2010-183020 (P2010-183020)	(73) 特許権者	000190149
(22) 出願日	平成22年8月18日 (2010. 8. 18)		信越半導体株式会社
(65) 公開番号	特開2012-43931 (P2012-43931A)		東京都千代田区大手町二丁目6番2号
(43) 公開日	平成24年3月1日 (2012. 3. 1)	(73) 特許権者	390004581
審査請求日	平成24年7月17日 (2012. 7. 17)		三益半導体工業株式会社
前置審査			群馬県高崎市保渡田町2 1 7 4 番地 1
		(74) 代理人	100102532
			弁理士 好宮 幹夫
		(72) 発明者	江原 幸治
			群馬県安中市磯部二丁目1 3 番1号 信越半導体株式会社 半導体磯部研究所内
		(72) 発明者	岡 鉄也
			群馬県安中市磯部二丁目1 3 番1号 信越半導体株式会社 半導体磯部研究所内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ウエーハの熱処理方法及びシリコンウエーハの製造方法並びに熱処理装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ウエーハの主表面（第一主表面）を支持部材で支持した状態で加熱源で加熱することで急速昇降温を伴う所定温度での熱処理を行うウエーハの熱処理方法において、

前記支持部材で支持した前記第一主表面の温度 T_a が、前記ウエーハの前記第一主表面とは反対側の主表面（第二主表面）の温度 T_b より $1 \sim 25$ 高くなり、前記第一主表面と支持部材の接触位置での前記シリコンウエーハの温度を T_p とすると、 $T_a > T_b > T_p$ の関係が成立するように前記加熱源を制御しながら熱処理を行うことを特徴とするウエーハの熱処理方法。

【請求項 2】

前記ウエーハの前記第一主表面を加熱する第一加熱源と、前記第二主表面を加熱する第二加熱源との出力比を変えることによって、前記第一主表面の温度が前記第二主表面の温度より $1 \sim 25$ 高くなるように制御することを特徴とする請求項 1 に記載のウエーハの熱処理方法。

【請求項 3】

前記第一加熱源及び前記第二加熱源としてハロゲンランプを用い、かつ前記第二加熱源の出力を前記第一加熱源の出力の $10 \sim 90\%$ とすることを特徴とする請求項 2 に記載のウエーハの熱処理方法。

【請求項 4】

前記加熱源としてハロゲンランプを用いることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 に

記載のウエーハの熱処理方法。

【請求項 5】

前記支持部材を、前記ウエーハの外周部を複数の支持点によって水平に支持するものとするを特徴とする請求項 1 ないし請求項 4 のいずれか 1 項に記載のウエーハの熱処理方法。

【請求項 6】

前記所定温度を、1250 以上とすることを特徴とする請求項 1 ないし請求項 5 のいずれか 1 項に記載のウエーハの熱処理方法。

【請求項 7】

前記所定温度を、700 以上1150 未満とすることを特徴とする請求項 1 ないし請求項 5 のいずれか 1 項に記載のウエーハの熱処理方法。

【請求項 8】

前記所定温度を、1150 以上1250 未満とすることを特徴とする請求項 1 ないし請求項 5 のいずれか 1 項に記載のウエーハの熱処理方法。

【請求項 9】

少なくとも、チョクラルスキー法によってシリコン単結晶棒を育成し、該シリコン単結晶棒をスライスしてシリコン単結晶基板に加工した後、該シリコン単結晶基板に対して請求項 1 ないし請求項 8 のいずれか 1 項に記載のウエーハの熱処理方法によって熱処理を行うことを特徴とするシリコンウエーハの製造方法。

【請求項 10】

ウエーハに対して急速昇降温を伴う所定温度での熱処理を行うための熱処理装置であって、少なくとも、

前記ウエーハを収容するためのチャンバーと、前記ウエーハの第一主表面を支持する支持部材と、前記ウエーハの前記第一主表面を加熱する第一加熱源と、前記ウエーハの前記第一主表面とは反対側の主表面（第二主表面）を加熱する第二加熱源と、前記第一加熱源と前記第二加熱源との出力を独立して制御するための制御機構とを備え、

前記制御機構は、前記第一加熱源及び前記第二加熱源の出力を前記支持部材で支持した前記第一主表面の温度 T_a が、前記ウエーハの前記第一主表面とは反対側の主表面（第二主表面）の温度 T_b より 1 ~ 25 高くなり、前記第一主表面と支持部材の接触位置での前記シリコンウエーハの温度を T_p とすると、 $T_a > T_b > T_p$ の関係が成立するように前記出力を独立して制御するものであることを特徴とする熱処理装置。

【請求項 11】

前記第一及び第二加熱源を、ハロゲンランプとすることを特徴とする請求項 10 に記載の熱処理装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、半導体ウエーハ等のようなウエーハの熱処理方法に関し、更に詳しくは、熱処理の際にウエーハとウエーハ支持部材の接触部から発生するスリップ転位を低減することが可能なウエーハの熱処理方法及び熱処理装置と、この熱処理工程を有するスリップ転位の少ないシリコンウエーハの製造方法及びシリコンウエーハに関するものである。

【背景技術】

【0002】

シリコン単結晶インゴットから切り出したシリコンウエーハは、デバイス製造するまでには、ウエーハの加工プロセスから素子の形成プロセスまで多数の工程が介在する。

これらの工程の一つに熱処理工程がある。そしてシリコンウエーハ加工工程においても、ウエーハ表層での無欠陥層の形成、酸素析出物の形成・制御を目的として熱処理を施す場合がある。

【0003】

この熱処理としては、従来バッチ式の熱処理が採用されていたが、近年ではより短時間

10

20

30

40

50

で急速昇降温して処理可能なRTA (Rapid Thermal Anneal) 装置を用いたランプアニール等による方法が広まりつつある。

しかし、通常のRTA処理では1100以上の高温でアニールされるため、スリップ転位が生じてしまうという問題点がある。このスリップ転位が発生すると、デバイス特性に悪影響を及ぼすため、デバイスを形成する表面から数 μm の領域にはスリップ転位がないことが要求されている。

【0004】

ここでスリップ転位は、シリコンウエーハを支持する支持ピンとウエーハの接触部にかかる自重による応力や、熱処理中にピンを通して熱が逃げてしまうために熱分布が不均一になることによる熱応力が主な発生原因と考えられている。

10

そして、この問題はウエーハの大口径化に伴い、自重が大きくなるにつれて顕著になってきた。また熱処理温度が高くなるほど発生しやすくなるという傾向がある。

【0005】

この問題の解決策として、特許文献1には、RTA処理する際にウエーハ外周部の温度が中心部の温度よりも1~6高くなるように熱処理温度を制御しながら熱処理する方法が開示されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0006】

【特許文献1】特開2010-34288号公報

20

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

しかしながら、本発明者らが鋭意検討した結果、上記特許文献1に記載の方法では、支持ピン位置から発生するスリップ転位を抑制することができないことが判明した。

特に、1250を超えるような高温では、ウエーハ裏面の支持ピン位置からスリップ転位が発生し、表面まで貫通してしまうという問題があった。

【0008】

この原因は、以下のとおりと推定される。

図3はウエーハ外周部の温度が中心部の温度より高い場合の概念図であり、図4はウエーハ中心部の温度が外周部の温度より高い場合の概念図である。

30

【0009】

特許文献1の記載によると、図4のようにウエーハWの中心部(T_i)の温度が外周部(T_o)の温度より高い($T_i > T_o$)場合は、ウエーハ中心部から支持ピン12を通して逃げる熱が大きく、温度差による熱応力 TS_{43} が、支持ピンとの反対側への熱応力 TS_{41} や外周部に向けての熱応力 TS_{42} に比べて相対的に大きくなり、スリップ転位が発生すると説明されている。

他方、図3のようにウエーハWの中心部より外周部の温度を高く($T_i < T_o$)すると、支持ピン12から逃げる熱が小さくなる(ウエーハ中心から外周に向かう熱流が減少すると解釈される)ため、温度差による熱応力 TS_{33} が図4の TS_{43} に比べて小さくなり、スリップ転位発生防止が図れると説明されている。

40

【0010】

しかしながら、本発明者らが鋭意検討した結果、図3のような場合、ウエーハWの外周部温度 T_o が高くなるため、外周部から中心に向かって流れる熱流が大きくなり、外周から支持ピンを通して逃げる熱は逆に多くなる。この結果、温度差による熱応力 TS_{32} が大きくなると考えられる。

そしてこの2つの効果が打ち消しあうために、スリップ転位の低減に効果がなかったと推定される。

【0011】

その他の問題点として、特許文献1に記載の方法では、ウエーハ面内の温度分布を不均

50

一にすることにより、酸化膜厚分布が不均一になるだけでなく、ウエーハ中心と外周部の温度差に起因する熱応力が大きくなり、ウエーハ外周部からスリップ転位が発生しやすくなるという問題がある。

特に、1250 を超えるような高温では、ウエーハ周辺部からスリップ転位が顕著に発生するという問題点があることを見出した。

【0012】

本発明は、上記問題に鑑みなされたものであって、シリコンウエーハを熱処理する際に、ウエーハ支持位置から発生するスリップ転位を確実に抑制することができるウエーハの熱処理方法とそれを実施することができる熱処理装置、およびこの方法を利用したウエーハ支持位置から発生したスリップ転位が従来より大幅に少ない、あるいは少なくとも表面に貫通していないシリコンウエーハとその製造方法を提供することを目的とする。

10

【課題を解決するための手段】

【0013】

上記課題を解決するため、本発明では、ウエーハの主表面（第一主表面）を支持部材で支持した状態で加熱源で加熱することで急速昇降温を伴う所定温度での熱処理を行うウエーハの熱処理方法において、前記支持部材で支持した前記第一主表面の温度が、前記ウエーハの前記第一主表面とは反対側の主表面（第二主表面）の温度より1～25 高くなるように前記加熱源を制御しながら熱処理を行うことを特徴とするウエーハの熱処理方法を提供する。

【0014】

このように、支持部材で支持したウエーハの第一主表面の温度が、第一主表面とは反対側の第二主表面の温度より1～25 高くなるように制御しながら熱処理を行うことによって、支持部材付近で発生する熱応力を小さくすることができ、スリップ転位の発生を従来に比べて確実に抑制することができるようになり、スリップ転位の少ない熱処理済みウエーハが得られる。

20

【0015】

なお、本発明における急速昇降温を伴う所定温度での熱処理とは、昇温速度又は降温速度が5～250 /秒、望ましくは20～150 /秒、更に望ましくは30～70 /秒の急速加熱又は急速冷却を伴う熱処理（RTA処理）のことをいう。また、所定温度とは、700 以上ウエーハの融点未満の温度範囲のことをいう。

30

【0016】

ここで、前記ウエーハの前記第一主表面を加熱する第一加熱源と、前記第二主表面を加熱する第二加熱源との出力比を変えることによって、前記第一主表面の温度が前記第二主表面の温度より1～25 高くなるように制御することが好ましい。

このように、ウエーハの第一主表面を加熱する第一加熱源と、第二主表面を加熱する第二加熱源との出力比を変えることによって、第一主表面の温度を第二主表面の温度より1～25 高くなるように制御することができる。これによって、容易かつ確実に第一主表面の温度を第二主表面の温度より1～25 高くなるように制御することができ、より確実にスリップ転位の発生を抑制することができる。

【0017】

また、前記第一加熱源及び前記第二加熱源としてハロゲンランプを用い、かつ前記第二加熱源の出力を前記第一加熱源の出力の10～90%とすることができる。

このように、第一加熱源及び第二加熱源としてハロゲンランプを用い、かつ第二加熱源の出力を第一加熱源の出力の10～90%とすることによって、更に容易かつ確実に第一主表面の温度を第二主表面の温度より1～25 高くなるように制御することができ、スリップ転位の発生を更に効果的に抑制することができる。

40

【0018】

そして、前記加熱源としてハロゲンランプを用いることができる。

このように、加熱源としてハロゲンランプを用いることによって、急速加熱を容易に行うことができ、熱処理の実施がより容易になる。

50

【0019】

更に、前記支持部材を、前記ウエーハの外周部を複数の支持点によって水平に支持するものとするのが好ましい。

ウエーハの支持部材としてはウエーハのエッジ部を全周にわたり薄いリング状のサセプターで支える方法もあるが、本発明のウエーハの熱処理方法は、ウエーハ外周部を複数の支持点で支える場合に特に有効である。

【0020】

また、前記所定温度を、700 以上1150 未満とすることができる。

支持部材が位置する箇所からのスリップ転位は、熱処理温度が700 以上の場合に顕著に発生するが、本発明のウエーハの熱処理方法は、そのような700 以上の処理温度で顕著に発生するスリップ転位の抑制に特に効果的である。

10

【0021】

そして、前記所定温度を、1150 以上1250 未満とすることができる。

近年、ウエーハとしてシリコンウエーハを用いる場合、シリコンウエーハにRTA処理を行って酸素析出物の制御を行う方法が開示され（例えば特表2001-503009号公報等参照）、広く採用されつつある。そして、そのRTA処理の処理温度は、多くが1150 以上1250 未満である。このように高温になると、スリップ転位の発生は更に顕著になるため、本発明のウエーハの熱処理方法は、1150 以上1250 未満でのRTA処理をする場合にはより有効である。

【0022】

更に、前記所定温度を、1250 以上とすることができる。

また、最近では1300 より高温でRTA処理することによりグローイン欠陥（例えばCOP）が溶解する方法が開示されている（例えば特開2010-40589号公報等参照）。

20

本発明者が鋭意検討した結果、RTA温度が1250 未満の場合はスリップ転位が支持部材での支持位置から発生するが、表面までは貫通していないので、デバイス特性に直接悪影響を及ぼすことはさほどない。しかしながらスリップ転位の発生によりウエーハ強度低下の問題があり、スリップ転位は少ない方が望ましいことから、上述のように1250 未満の場合でも本発明のウエーハの熱処理方法は特に好適に行うことができる。

そして1250 以上では、支持部材位置から発生したスリップ転位は表面まで貫通してしまうため、デバイス特性へ著しい悪影響を及ぼす。しかしながら本発明のウエーハの熱処理方法の場合は、例えスリップ転位が発生したとしてもスリップ転位が表面に貫通せずに、バルク中でスリップ転位の多くを止めることができ、デバイス作製領域である表面から数 μm の範囲には転位の発生がないものとする事ができる。

30

このように本発明のウエーハの熱処理方法は、1250 以上の温度での熱処理を行う場合に特に有効である。

【0023】

また、本発明では、少なくとも、チョクラルスキー法によってシリコン単結晶棒を育成し、該シリコン単結晶棒をスライスしてシリコン単結晶基板に加工した後、該シリコン単結晶基板に対して本発明に記載のウエーハの熱処理方法によって熱処理を行うことを特徴とするシリコンウエーハの製造方法を提供する。

40

上述のように、本発明のウエーハの熱処理方法は、スリップ転位の発生を確実に抑制することができるため、これを利用したシリコンウエーハの製造方法によれば、従来よりスリップ転位が大幅に低減された良好な品質のシリコンウエーハを従来より効率的に製造することができるようになる。

【0024】

そして、本発明では、シリコンウエーハであって、本発明に記載のウエーハの熱処理方法によって熱処理されたものであることを特徴とするシリコンウエーハを提供する。

上述のように、本発明のウエーハの熱処理方法が施されたシリコンウエーハは、従来よりスリップ転位が大幅に低減された良好な品質のものである。

50

【0025】

更に、本発明では、ウエー八に対して急速昇降温を伴う所定温度での熱処理を行うための熱処理装置であって、少なくとも、前記ウエー八を収容するためのチャンバーと、前記ウエー八の第一主表面を支持する支持部材と、前記ウエー八の前記第一主表面を加熱する第一加熱源と、前記ウエー八の前記第一主表面とは反対側の主表面（第二主表面）を加熱する第二加熱源と、前記第一加熱源と前記第二加熱源との出力を独立して制御するための制御機構とを備え、前記制御機構は、前記第一加熱源及び前記第二加熱源の出力を前記支持部材で支持した前記第一主表面の温度が、前記ウエー八の前記第一主表面とは反対側の主表面（第二主表面）の温度より1～25 高くなるように前記出力を独立して制御するものであることを特徴とする熱処理装置を提供する。

10

【0026】

これによって、熱処理中におけるウエー八内の支持部材付近での熱応力を従来に比べて小さくすることができるようになり、熱処理後のウエー八に発生していたスリップ転位の発生率を大きく低減することができ、スリップ転位の少ないウエー八を得ることができる装置となる。

【0027】

ここで、前記第一及び第二加熱源を、ハロゲンランプとすることが好ましい。

このように、加熱源をハロゲンランプとすることによって、急速加熱を容易に行うことができ、また第一主表面の温度を第二主表面の温度より高く制御する熱処理の実施がより容易になる。

20

【発明の効果】

【0028】

以上説明したように、本発明によれば、シリコンウエー八を熱処理する際に、ウエー八支持位置から発生するスリップ転位を確実に抑制することができるウエー八の熱処理方法とそれを実施することができる熱処理装置、およびこの方法を利用したウエー八支持位置から発生したスリップ転位が従来より大幅に少ない、あるいは少なくとも表面に貫通していないシリコンウエー八とその製造方法が提供される。

【図面の簡単な説明】

【0029】

【図1】本発明のウエー八を支持する支持部材と接触する第一主表面の温度が、第二主表面の温度より1～25 高くなるように加熱源を制御しながら熱処理を行う際の概念図である。

30

【図2】本発明の熱処理装置の概略の一例を示した図である。

【図3】従来の熱処理方法におけるウエー八外周部の温度が中心部の温度より高い場合の概念図である。

【図4】従来の熱処理方法におけるウエー八中心部の温度が外周部の温度より高い場合の概念図である。

【図5】従来のウエー八を支持する支持部材と接触する第一主表面の温度を、第二主表面の温度と等しくして熱処理を行う際の概念図である。

【発明を実施するための形態】

40

【0030】

以下、本発明について図を参照して詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。図2は本発明の熱処理装置の概略の一例を示した図である。

【0031】

図2に示すように、ウエー八Wに対して急速昇降温を伴う所定温度での熱処理（RTA処理）を行うための本発明の熱処理装置10は、少なくとも、ウエー八Wを収容するための石英からなるチャンバー11と、例えば石英トレイ16に形成されたウエー八Wの第一主表面を支持する支持部材（例えば3点支持ピン）12と、ウエー八Wを加熱するための加熱源13としての、ウエー八Wの第一主表面を加熱する第一加熱源（例えばハロゲンランプ）14aと、ウエー八Wの第一主表面とは反対側の主表面（第二主表面）を加熱する

50

第二加熱源（例えばハロゲンランプ）14bと、第一加熱源14aと第二加熱源14bとの出力を独立して制御するための制御機構15とを備えるものである。

【0032】

また、チャンバー11には不図示の温度測定用特殊窓が設けられており、チャンバー11の外部に設置されたパイロメータ19により、その特殊窓を通してウエーハWの温度を測定することができ、その測定温度の信号を制御機構15へ伝送するようになっているものとするができる。この場合、パイロメータ19は、ウエーハWの第一主表面の温度を測定する第一パイロメータ19aと、第二主表面の温度を測定する第二パイロメータ19bを具備し、それぞれ測定温度を制御機構15へ伝送するようにしても良い。

【0033】

そして制御機構15は、設定温度と実測されたウエーハ温度との差や予めレシピーで設定された電力比率に従って電力供給装置21a（第一加熱源14a制御用）、21b（第二加熱源14b制御用）を制御し、第一加熱源14a及び第二加熱源14bの出力を、支持部材12で支持した第一主表面の温度が第二主表面の温度より1～25 高くなるように独立して出力を制御することができるようになっているものである。

【0034】

また、熱処理時の雰囲気ガスについては、石英トレイ16のガス導入口20a側には、石英製のバッファ18が設けられており、酸化性ガスや窒化性ガス、Arガス等の導入ガスがウエーハWに直接当たるのを防ぐことができるようになっている。そしてガスの排気側は、オートシャッター17が装備され、外気を封鎖している。オートシャッター17は、ゲートバルブによって開閉可能に構成される不図示のウエーハ挿入口が設けられている。また、オートシャッター17にはガス排気口20bが設けられており、炉内雰囲気を調整できるようになっている。

【0035】

このような構造の熱処理装置10では、ウエーハの第一主表面を加熱する第一加熱源14aと、ウエーハの第一主表面とは反対側の主表面（第二主表面）を加熱する第二加熱源14bとを、第一主表面の温度が第二主表面の温度より1～25 高くなるように出力を独立して制御する制御機構15によって独立して出力を制御するものとなり、ウエーハの熱処理中において、ウエーハ内部での熱流が、支持部材方向に向けての熱流だけでなく、ウエーハ表面に向かって流れる熱流を発生させることができる。そしてこの熱流が存在することによって、支持部材近傍での温度勾配が小さくなり、支持部材付近での熱応力を従来に比べて小さくすることができる。従って、支持部材付近で顕著に発生する熱処理後のウエーハのスリップ転位の発生が従来に比べて著しく抑制されることになり、スリップ転位の少ない高品質熱処理済みウエーハを得ることができる熱処理装置とすることができる。

【0036】

第一主表面の温度が第二主表面の温度より1～25 高くなるように温度制御する方法としては上記以外に例えば以下の方法も考えられる。

第一主表面の温度を測定するパイロメータ19aのみを具備し、このパイロメータ19aを用いて予め酸素雰囲気中でRTA処理を行い、加熱源の出力、温度、酸化膜厚との関係を求めておき、この関係を用いて、第一主表面と第二主表面の温度差が所定の温度差になるように、第一加熱源14aと第二加熱源14bの出力を決定することができる。

さらに、第一加熱源14aと第二加熱源14bのランプ1本当たりの出力は一定とし、第一加熱源14aと第二加熱源14bのランプ本数比率を変えることも可能である。

あるいは、第一加熱源14aと第二加熱源14bのランプの種類（発光特性の異なるランプ）を変えることにより、供給電力は一定であっても発光特性が異なるため、結果として第一加熱源14aと第二加熱源14bの出力比を変えることも可能である。

【0037】

上記のような本発明の熱処理装置を用いた本発明のウエーハの熱処理方法の一例を以下に示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

10

20

30

40

50

【 0 0 3 8 】

本発明の熱処理方法の特徴は、シリコンウエーハに代表されるウエーハを、支持部材で支持した状態で加熱源で加熱することで急速昇降温を伴う所定温度での熱処理を行う際に、支持部材で支持した第一主表面の温度が、ウエーハの第一主表面とは反対側の主表面（第二主表面）の温度より1～25 高くなるように加熱源を制御しながら熱処理を行うものである。

これにより支持部材でのウエーハ支持位置から発生するスリップ転位を確実に抑制できるメカニズムは明確ではないが、以下のとおりであると推定される。

【 0 0 3 9 】

図1は、本発明のように、ウエーハを支持する支持部材と接触する第一主表面の温度が、第二主表面の温度より1～25 高くなるように加熱源を制御しながら熱処理を行う際の概念図である。また、図5は、従来のように、ウエーハを支持する支持部材と接触する第一主表面の温度を、第二主表面の温度と等しくして熱処理を行う際の概念図である。

【 0 0 4 0 】

図5のように、ウエーハを支持する支持部材12と接触する第一主表面 W_a の温度と第二主表面 W_b の温度を等しくした場合、シリコンウエーハ W の第二主表面 W_b の温度 T_b と、支持部材12とシリコンウエーハ W の第一主表面 W_a での接触位置から少し離れたシリコンウエーハの第一主表面の温度 T_a と、支持部材位置でのシリコンウエーハの温度を T_p とすると、 $T_a = T_b > T_p$ の関係が成立している。

このため、温度差により生じる熱流は、

- (1) 第一主表面 W_a から支持部材12に向かって流れる熱流 TF_{51}
- (2) 第二主表面 W_b から支持部材12に向かって流れる熱流 TF_{52}

の2種類が主に生じることになる。このため、支持部材12近傍での温度勾配が大きくなり、大きな熱応力を生じ、スリップ転位が発生する、と考えられる。

【 0 0 4 1 】

これに対し、本発明に係る図1の場合、シリコンウエーハ W の第二主表面 W_b の温度 T_b と、支持部材12とシリコンウエーハ W の第一主表面 W_a での接触位置から少し離れたシリコンウエーハの第一主表面 W_a の温度 T_a と、第一主表面 W_a と支持部材12の接触位置でのシリコンウエーハ W の温度を T_p とすると、 $T_a > T_b > T_p$ の関係が成立する。

このため、温度差により生じる熱流は、

- (1) 第一主表面 W_a から支持部材12に向かって流れる熱流 TF_{11}
- (2) 第一主表面 W_a から第二主表面 W_b に向かって流れる熱流 TF_{13}
- (3) ウエーハ W のバルク部から支持部材12に向かって流れる熱流 TF_{12}
- (4) ウエーハ W のバルク部から第二主表面 W_b に向かって流れる熱流 TF_{14}

の4種類となり、支持部材12へ向かう熱流だけでなく、第二主表面 W_b 側に向かって流れる熱流 TF_{13} 、 TF_{14} が存在するようになる。

この結果、支持部材12の近傍での温度勾配が従来の場合に比べて小さくなり、熱応力が小さくなるため、スリップ転位の発生を確実に抑制することができるようになると考えられる。

【 0 0 4 2 】

なお、ウエーハ W の第一主表面 W_a の温度と第二主表面 W_b の温度差が1 未満では、第一主表面 W_a から第二主表面 W_b に向かって流れる熱流 TF_{13} やウエーハバルク部から第二主表面 W_b に向かって流れる熱流 TF_{14} が小さくなるためにスリップ転位発生を抑制するメカニズムがほとんど働かず、スリップ転位の発生をほとんど抑制できない。

また、ウエーハ W の第一主表面 W_a の温度と第二主表面 W_b の温度差が25 より大きい場合、第一主表面 W_a と第二主表面 W_b との温度差が大きくなり過ぎるため、ウエーハ内の熱流 TF_{13} 及び TF_{14} が大きくなって、ウエーハ内に生じる熱応力が大きくなってしまい、スリップ転位の発生を抑制することが困難となる。

そのため、支持部材で支持したウエーハの第一主表面の温度が、第一主表面とは反対側

10

20

30

40

50

の第二主表面の温度より1～25 高くなるように制御しながら熱処理を行う必要がある。

【0043】

このように、支持部材で支持したウエーハの第一主表面の温度が、第一主表面とは反対側の第二主表面の温度より1～25 高くなるように制御しながら熱処理を行うことによって、上述のように、熱処理中において、支持部材方向に向けての熱流だけでなく、表面に向かって流れる熱流が存在することとなり、支持部材近傍での温度勾配が小さくなることになる。そのため、支持部材付近で発生する熱応力が小さくなり、これによってスリップ転位の発生を従来に比べて著しく抑制することができ、スリップ転位の少ないウエーハが得られる。

10

【0044】

ここで、ウエーハWの第一主表面 W_a を加熱する第一加熱源14aと、第二主表面 W_b を加熱する第二加熱源14bとの出力比を変えることによって、第一主表面 W_a の温度が第二主表面 W_b の温度より1～25 高くなるように制御することができる。

このように、ウエーハの第一主表面を加熱する第一加熱源と、第二主表面を加熱する第二加熱源との出力比を変えることとすれば、安定かつ確実に第一主表面の温度を第二主表面の温度より1～25 高くなるように制御することができ、より安定かつ確実にスリップ転位の発生を抑制することができる。

【0045】

また、加熱源13、特に第一加熱源14a及び第二加熱源14bとしてハロゲンランプを用いることができる。そして第二加熱源14bの出力を第一加熱源14aの出力の10～90%とすることができる。

20

このように、加熱源、特に第一加熱源、第二加熱源としてハロゲンランプを用いることによって、急速加熱を容易に行うことができ、熱処理の実施がより容易になる。

そして、第二加熱源の出力を第一加熱源の出力の10～90%とすることによって、より安定かつ確実に第一主表面の温度を第二主表面の温度より1～25 高くなるように制御することができるので、更にスリップ転位の発生を確実に抑制することができる。

【0046】

更に、支持部材12を、ウエーハWの外周部を複数の支持点によって水平に支持するものとすることができる。

30

上述のように、本発明のウエーハの熱処理方法は、ウエーハ外周部を複数の支持点で支える場合であっても、スリップ転位の発生を抑制することができるため、ウエーハWの外周部を複数の支持点によって水平に支持するタイプのサセプターを好適に使用することができる。

【0047】

また、ウエーハを加熱する所定温度を、700 以上1150 未満、1150 以上1250 未満、1250 以上(望ましくはウエーハの融点温度未満)の何れかの温度とすることができる。

【0048】

一般的にシリコンウエーハに熱処理を行う場合、加熱する温度が700 以上になるとウエーハを支持する支持部材の箇所からスリップ転位が発生し易くなる。しかし、スリップ転位の発生を確実に抑制することができる本発明のウエーハの熱処理方法であれば、そのような700 以上の処理温度で発生するスリップ転位を、確実にその発生を抑制することができるため、好適である。

40

【0049】

また、シリコンウエーハにRTA処理を行って酸素析出物の制御を行う場合には、処理温度は1150 以上1250 未満で行われることが多いが、このように高温になるとスリップ転位の発生は顕著になる。

そのような場合に、本発明のウエーハの熱処理方法は特に効果的に用いることができるものである。

50

【0050】

そして、1300より高温でRTA処理することによりグローイン欠陥(COP等)が溶解することが知られているが、スリップ転位の発生を確実に抑制することができる本発明のウエーハの熱処理方法は、支持部材位置から発生したスリップ転位が表面まで貫通しやすくなる1250以上の温度での熱処理を行う場合にも特に有効である。

【0051】

そして、チョクラルスキー法によってシリコン単結晶棒を育成し、シリコン単結晶棒をスライスしてシリコン単結晶基板に加工した後、シリコン単結晶基板に対して本発明に記載のウエーハの熱処理方法によって熱処理を行うことによって、従来よりスリップ転位が大幅に低減された高品質シリコンウエーハを従来より効率的に製造することができる。

10

【0052】

なお、このとき、作製するシリコン単結晶基板は、一般的なものであれば良く、導電型や抵抗率などの電気特性値や結晶方位、結晶径等は特に限定されない。ただし、本発明は自重がより重くなり、スリップ転位がより発生し易い直径8インチ(200mm)、12インチ(300mm)あるいはそれ以上の大口径ウエーハの熱処理において特に有効である。

また、シリコン単結晶棒からシリコン単結晶基板への加工についても、一般的なものとすれば良く、例えば内周刃スライサあるいはワイヤソー等の切断装置によってスライスすることができる。またラッピング・エッチング・研磨等を一般的な条件で行うことができ、製造するシリコンウエーハの仕様に応じて適宜選択することができる。

20

【実施例】

【0053】

以下、実施例及び比較例を示して本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

(実施例1-5、比較例1-3)

急速昇降温する熱処理装置としてMattson社製のHeliosを用いた。また該装置に、第二加熱源に相当する上側ランプモジュール(ハロゲンランプ)と第一加熱源に相当する下側ランプモジュール(ハロゲンランプ)のランプ出力を任意の比率で変更できるようにした制御機構を加えた。

そして、直径300mmのp型シリコンウエーハを準備し、熱処理装置の開口部からチャンパー内に搬入し、3本の石英製支持ピンに載せて水平に保持した。この時、支持ピンで支持した側を第一主表面、反対側を第二主表面とした。

30

【0054】

その後、酸素ガスをチャンパー内に導入し、50/secで所定の熱処理温度まで昇温し、所定温度(1200、1250、1300、1350)で、それぞれ10秒間熱処理を行った。

その後50/secの降温速度で800まで下げた段階で加熱をOFFにした後、チャンパー内で500まで冷却し、その後にウエーハを取り出した。

【0055】

この熱処理時の上側ランプモジュールと下側ランプモジュール出力比率は比較例1では上側：下側=100：100(温度差(第一主表面-第二主表面)0)とした。また比較例2では上側：下側=100：60(温度差-5)、実施例1では上側：下側=90：100(温度差1)、実施例2では上側：下側=80：100(温度差8)、実施例3では上側：下側=40：100(温度差15)、実施例4では上側：下側=20：100(温度差18)、実施例5では上側：下側=10：100(温度差23)、比較例3では上側：下側=5：100(温度差33)とした。

40

【0056】

その後第一主表面及び第二主表面の酸化膜厚さをエリプソメーターで測定し、その膜厚より、第一主表面及び第二主表面の温度差を算出した。

更に、レーザー散乱方式の異物検査装置(KLA-Tencor社製SP1)でウエ

50

ー八表面（第二主表面）のスリップ転位測定を行った。

その結果を表 1 に示す。なお表 1 中の は 3 つの支持ピン位置のいずれにおいてもスリップ転位発生なし、 は 1 または 2 箇所スリップ転位発生、 × は 3 箇所すべてでスリップ転位発生を意味するものである。

【 0 0 5 7 】

【表 1】

	ハロゲンランプのパワー比率(第一主表面:第二主表面)	温度差(°C)(第一主表面-第二主表面)	1200°C	1250°C	1300°C	1350°C
比較例1	100:100	0	○	×	×	×
比較例2	60:100	-5	○	×	×	×
実施例1	100:90	1	○	○	○	△
実施例2	100:80	8	○	○	○	○
実施例3	100:40	15	○	○	○	○
実施例4	100:20	18	○	○	○	○
実施例5	100:10	23	○	○	○	△
比較例3	100:5	33	○	○	△	×

10

【 0 0 5 8 】

表 1 から明確なように、第二主表面の温度より第一主表面の温度を 1 ~ 2 3 高くした実施例 1 ~ 実施例 5 でスリップ転位の発生が大幅に抑制されており、本発明が効果的であることが確認された。

なお 1 2 0 0 の場合には、比較例 1 - 3、実施例 1 - 5 全てでスリップ転位の発生はないが、これは S P 1 で検出するスリップ転位は表面のみであることに起因する。この場合でも X 線や選択エッチングで評価を行えば支持ピンとウエー八が接触した部分からスリップ転位が発生し、バルクの表面方向にスリップ転位が伸びているが、表面まで貫通していないため、S P 1 では検出されていないだけである。X 線で内部を観察した結果、いずれの場合においても、比較例 1 - 3 に比べて実施例 1 - 5 の方法で熱処理したウエー八はスリップ転位は短くなっており、スリップ転位の防止あるいは低減に効果があることが確認された。

20

【 0 0 5 9 】

(実施例 6、比較例 4)

急速昇降温する熱処理装置として M a t t s o n 社製の H e l i o s を用いた。また該装置に、第二加熱源に相当する上側ランプモジュール（ハロゲンランプ）と第一加熱源に相当する下側ランプモジュール（ハロゲンランプ）のランプ出力を任意の比率で変更できるようにした制御機構を加えた。

30

そして、直径 3 0 0 m m の p 型シリコンウエー八を準備し、R T A 装置の開口部からチャンパー内に搬入し、3 本の石英製支持ピンに載せて水平に保持した。この時、支持ピンで支持した側を第一主表面、反対側を第二主表面とした。

【 0 0 6 0 】

その後、酸素ガスをチャンパー内に導入し、5 0 / s e c で所定の熱処理温度まで昇温し、所定温度（7 0 0 、 1 1 0 0 、 1 3 0 0 ）で、それぞれ 1 0 秒間熱処理を行った。

その後 5 0 / s e c の降温速度で 8 0 0 まで下げた段階で加熱を O F F にした後、チャンパー内で 5 0 0 まで冷却し、その後にウエー八を取り出した。

40

【 0 0 6 1 】

この時の上側ランプモジュールと下側ランプモジュール出力比率およびウエー八外周部と内周部の温度差を、比較例 4 では上側：下側 = 1 0 0 : 1 0 0 (温度差 (第一主表面 - 第二主表面) 0)、ウエー八外周部の温度が中心部の温度より 5 高くなるようにした。そして実施例 6 では上側：下側 = 4 0 : 1 0 0 (温度差 1 5)、ウエー八外周部の温度と中心部の温度は同一とした。

【 0 0 6 2 】

熱処理後に、レーザー散乱方式の異物検査装置（K L A - T e n c o r 社製 S P 1 ）でウエー八表面のスリップ転位測定および支持ピン接触位置から発生したスリップ転位の

50

長さを選択エッチングで評価した。その結果を表 2 に示す。表中の ○ は 3 つの支持ピン位置のいずれにおいてもスリップ転位発生なし、○ は 1 または 2 箇所スリップ転位発生、× は 3 箇所すべてでスリップ転位発生を意味する。

【 0 0 6 3 】

【表 2】

		700°C	1100°C	1300°C	ハロゲンランプのパワー比率(第一主表面:第二主表面)
比較例4	表面スリップ	○	○	×	100:100
	スリップ転位長さ(mm)	0.5	2	8	
実施例6	表面スリップ	○	○	○	100:40
	スリップ転位長さ(mm)	0.2	1.2	3	

10

【 0 0 6 4 】

表 2 から明確なように、比較例 4 (特許文献 1 記載の方法) では、1300 で熱処理した場合に支持ピン位置から発生したスリップ転位が表面(第二主表面)まで貫通していた。これに対して、実施例 6 では、スリップ転位は表面まで貫通していないため、SP1 ではスリップ転位として検出されていなかった。

また比較例 4 の場合には、1300 で RTA 処理した場合にはウエーハエッジ部からのスリップ転位発生も認められた。その他のウエーハにおいては、エッジ部から発生するスリップ転位はなかった。

20

さらに、支持ピン位置から発生したスリップ転位の長さも、比較例 4 に比べて、実施例 6 はいずれの温度でも改善しており、本発明の方法が、スリップ転位防止あるいは低減に効果があることが確認された。

【 0 0 6 5 】

なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は例示であり、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。

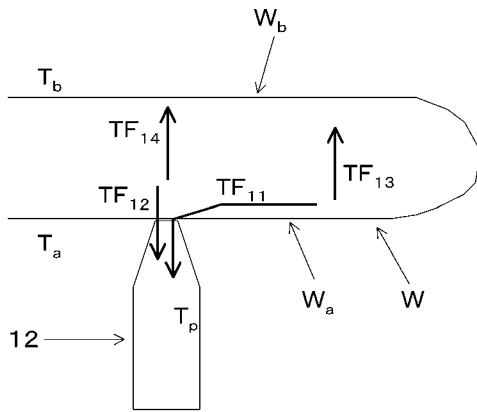
【符号の説明】

【 0 0 6 6 】

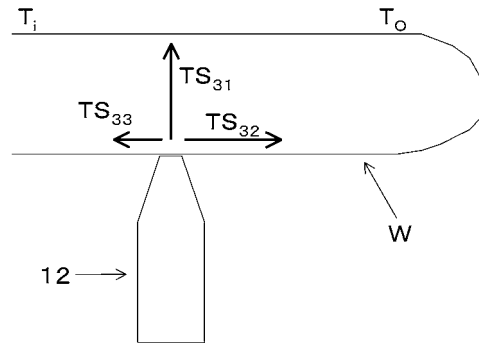
10 ... 熱処理装置、
 11 ... チャンバー、 12 ... 支持部材(支持ピン)、 13 ... 加熱源、 14 a ... 第一加熱源、 14 b ... 第二加熱源、 15 ... 制御機構、 16 ... 石英トレイ、 17 ... オートシャッター、 18 ... パッファ、 19 ... パイロメータ、 20 a ... ガス導入口、 20 b ... ガス排気口、 21 a, 21 b ... 電力供給機構、
 TF₁₁, TF₁₂, TF₁₃, TF₁₄, TF₅₁, TF₅₂ ... 熱流、
 TS₃₁, TS₃₂, TS₃₃, TS₄₁, TS₄₂, TS₄₃ ... 熱応力、
 W ... ウエーハ(シリコンウエーハ)、 W_a ... 第一主表面、 W_b ... 第二主表面。

30

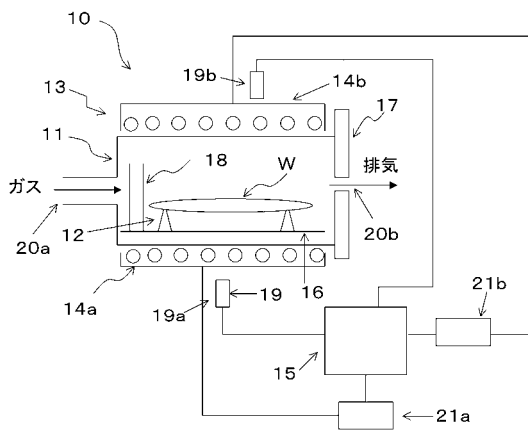
【図1】
 $T_a > T_b > T_p$



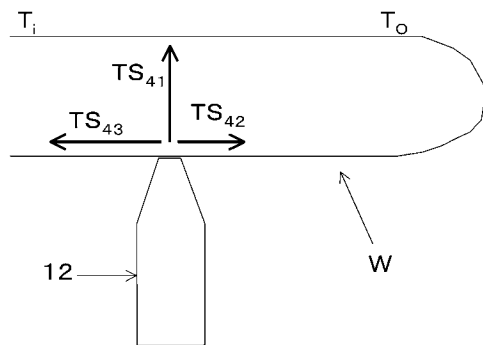
【図3】
 $T_i < T_o$



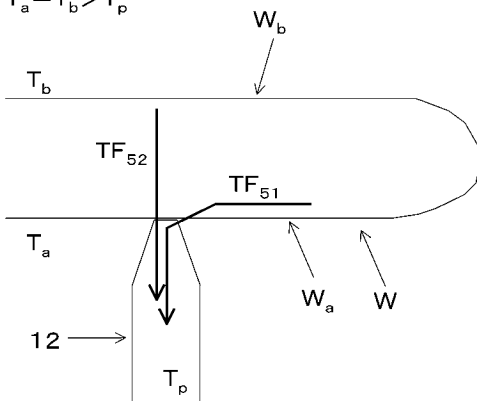
【図2】



【図4】
 $T_i > T_o$



【図5】
 $T_a = T_b > T_p$



フロントページの続き

(72)発明者 高橋 修治

群馬県高崎市保渡田町2174番1号 三益半導体工業株式会社 上郊工場内

審査官 柴山 将隆

(56)参考文献 特開平02-045914(JP,A)
特開2010-034288(JP,A)
特開2010-073782(JP,A)
特開2010-109100(JP,A)
特開2008-016652(JP,A)
特開昭63-221612(JP,A)
特開2008-117892(JP,A)
特開平09-017742(JP,A)
特表2007-519232(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

H01L	21/26
C30B	29/06
C30B	33/02